

FOUP300EX

FOUP (Front Opening Unified Pod)



Applications

- 300mm wafer process carrier

Features

- Single molded structure minimizing cleaning drying cycle time
- Entire ESD shell and door
- Excellent seal capability
- Secure roller clamping latch mechanism
- Long life including gasket
- Conforms to SEMI Standard
- Option : Thin wafer solution

用途

- 300mm ウエハプロセスキャリア

特長

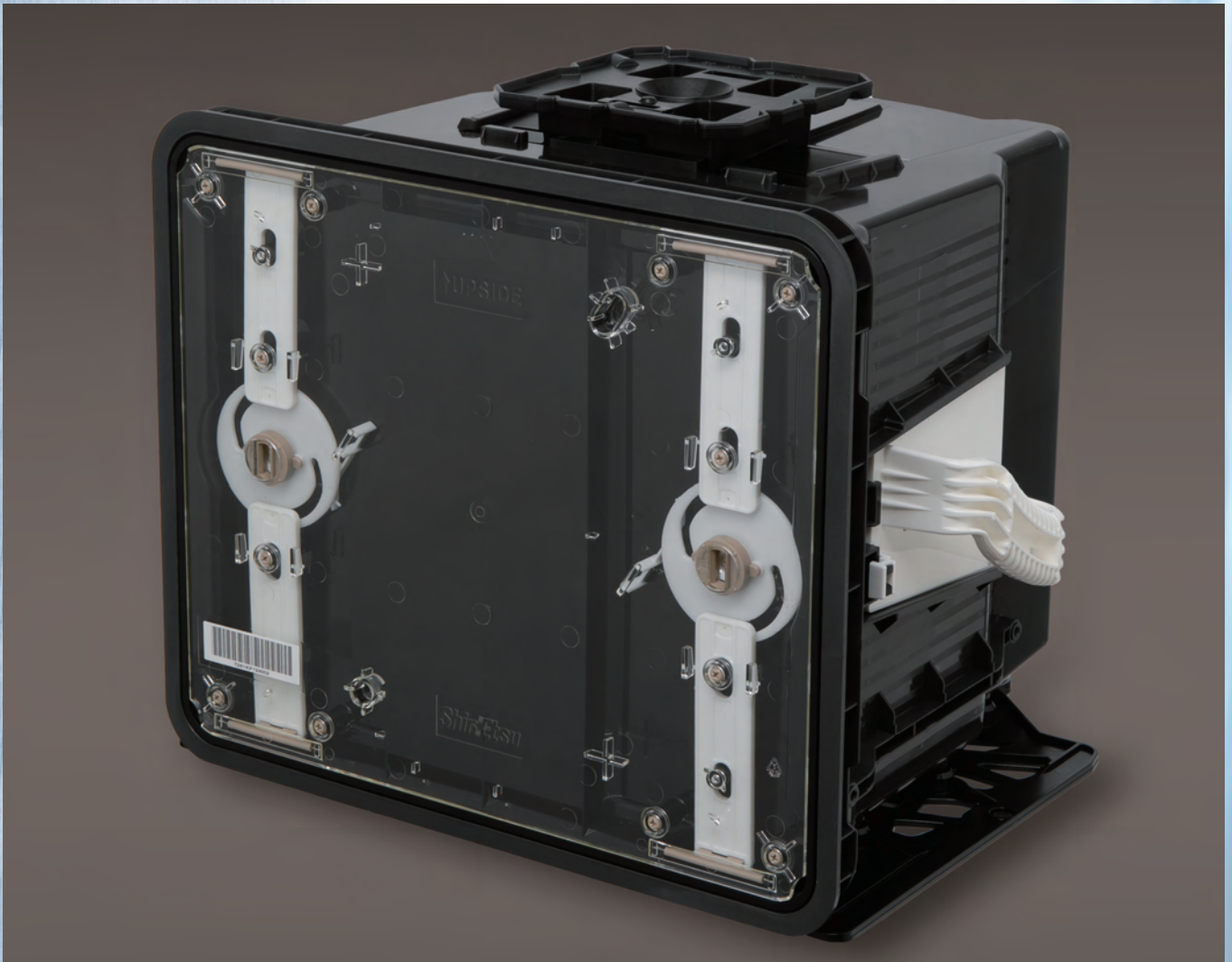
- 一体成形構造によって、洗浄後の乾燥時間を短縮
- ESDシェル、ドア
- 卓越したシール性
- 安全なローラーラッチ機構
- ロングライフ
- SEMI規格準拠
- オプション：薄ウエハ対応

ShinEtsu

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第一グループ
電話番号 03-5288-8413 FAX番号 03-5288-3113

AQUAPROOF FOUP300EX

FOUP (Front Opening Unified Pod)



Applications

- 300mm wafer process carrier

Features

- Maintain the low moisture FOUP inside
- Single molded structure minimizing cleaning drying cycle time
- Entire ESD shell and door
- Excellent seal capability
- Long life including gasket
- Conforms to SEMI Standard
- Option: Advanced Diffuser (AD-SAP FOUP)

用途

- 300mm ウエハプロセスキャリア

特長

- FOUP内を低湿度に保持
- 一体成形構造によって、洗浄後の乾燥時間を短縮
- ESDシェル、ドア
- 卓越したシール性
- ロングライフ
- SEMI規格準拠
- オプション: 高速・高均一窒素パージ用パーツ

ShinEtsu

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第一グループ
電話番号 03-5288-8413 FAX番号 03-5288-3113

MW300GT

Automated FOSB (Front Opening Shipping Box)



Applications

- 300mm wafer shipper with automated door

Features

- Robust structure for perfect seal during transportation
- Manual open / close function
- Single molded Structure minimizing cleaning drying cycle time
- Conforms to SEMI Standard

用 途

- 自動化対応300mm ウエハー輸送用容器

特 長

- 輸送中のシール性を保つ高剛性構造
- マニュアル開閉機能付き
- 一体成形構造によって、洗浄後の乾燥時間を短縮
- SEMI規格準拠

シンエツ ライトフレーム

ウエハーダイシング用樹脂製軽量テープフレーム

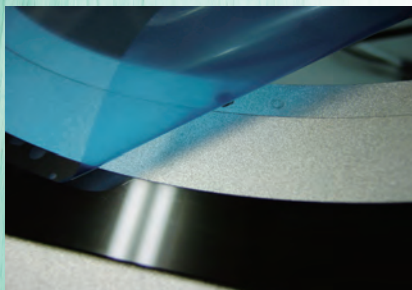
Shin-Etsu Lightframe SEMI G87-1108準拠(φ300mm用)

工程間で発生する
導電性異物を排除し、
パッケージの信頼性を
向上させます。

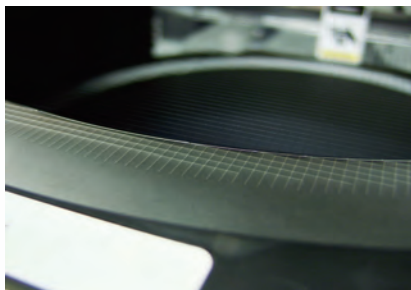


Applications

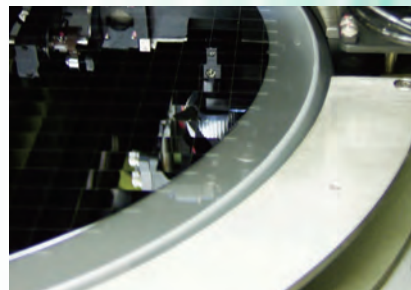
- Wafer dicing process carrier



【Technovision】
Wafer Mounting System
FM-Series (P-cut and normal tape)



【DISCO】
Fully Automatic Dicing Saw
DFD6361



【Shinkawa】
Die Bonder
SPA-300Super

用途

- ウエハーダイシングプロセスキャリア

Features

- Reducing Metal particles
- Light weight
- Usability
- Conforms to SEMI Standard

特長

- 金属異物低減
- 軽量化
- 作業性向上
- SEMI規格準拠 (φ300mm用)

品番	Size	外径 (OD)	内径 (ID)	幅 (W)	厚み (H)	参考
300NLF-EP	300mm	400mm	350mm	380mm	2.5mm	ラベル対応タイプ
200NLF-EP	8 inch	296mm	250mm	276mm	2.0mm	ラベル対応タイプ
200NLF-FF	8 inch	296mm	250mm	276mm	2.0mm	フルフラットタイプ
150NLF-FF	6 inch	228mm	194mm	212mm	1.5mm	フルフラットタイプ

ShinEtsu

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第一グループ
電話番号 03-5288-8413 FAX番号 03-5288-3113

シンエツ キャリアテープ

Shin-Etsu Carrier Tape

高性能デバイス用小型チップを梱包可能

Available for taping high-performance small chips.

微細部品対応キャリアテープ Carrier tape for small chips.

特性値／Characteristic Value

- シート幅／Sheet width : 4.0~8.0mm
- シート厚／Sheet thickness : 0.2mm
- 材質／Material : APET, PS
- ピッチ／Pitch : 0.5mm, 1.0mm, 2.0mm

特長／Features

- チップの回転防止形状／
Prevent Chip rotation
- 開口部R 最小化／
Minimization opening radius (R)
- 底穴0.15φ対応可能／
Available for center - hole (φ0.15mm)
- 棚構造対応可能／
Shelf pocket shape



0201サイズ対応
キャリアテープ
Carrier tape for
0201 size



0201サイズ対応
キャリアテープ
(流れ方向断面写真)
Carrier Tape for 0201 Size.
(Cross-Sectional View in the
Flow Direction)



0402サイズ
狭ピッチ (0.5mm) 対応
キャリアテープ
Carrier tape for 0402 size,
narrow pitch (0.5mm)



0.15φ底穴対応
キャリアテープ
Carrier tape with
φ0.15mm center -
hole



ポケット拡大図
Pocket enlarged view



棚構造対応
キャリアテープ
Carrier tape for
Shelf pocket shape



棚構造対応
キャリアテープ
(流れ方向断面写真)
Carrier tape for Shelf pocket
shape. (Cross-section photo
in the feeding direction)

シンエツ トップカバーテープ

Shin-Etsu Top Cover Tape

トップカバーテープSP21シリーズ Top Cover Tape SP21 Series

特性値／Characteristic Value

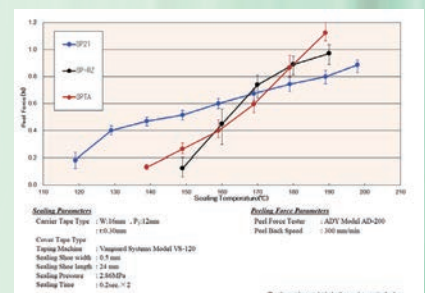
- 抵抗値／Resistance value : $7.4E+08\Omega$
(PET面) (PET surface)
(導電タイプ) (Conductive type)
 $1.1E+08\Omega$ (接着面) (Bonding surface)

特長／Features

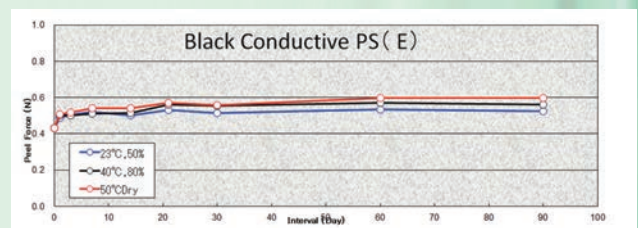
- 高い透明性／
High transparency
- 剥離タイプ：層間剥離／
Peeling Type : Interlayer Peeling
- 高速テーピング可能／
High-speed taping available
- 温度依存性が低い／
Low temperature dependence
- ドーミングを低減／
Reduction of film doming



SP21リール 画像
SP21 Reel Image



シール温度性 測定結果 (PS導電タイプ*SP21)
Seal Temperature Resistance Measurement Results (PS conductive type *SP21)



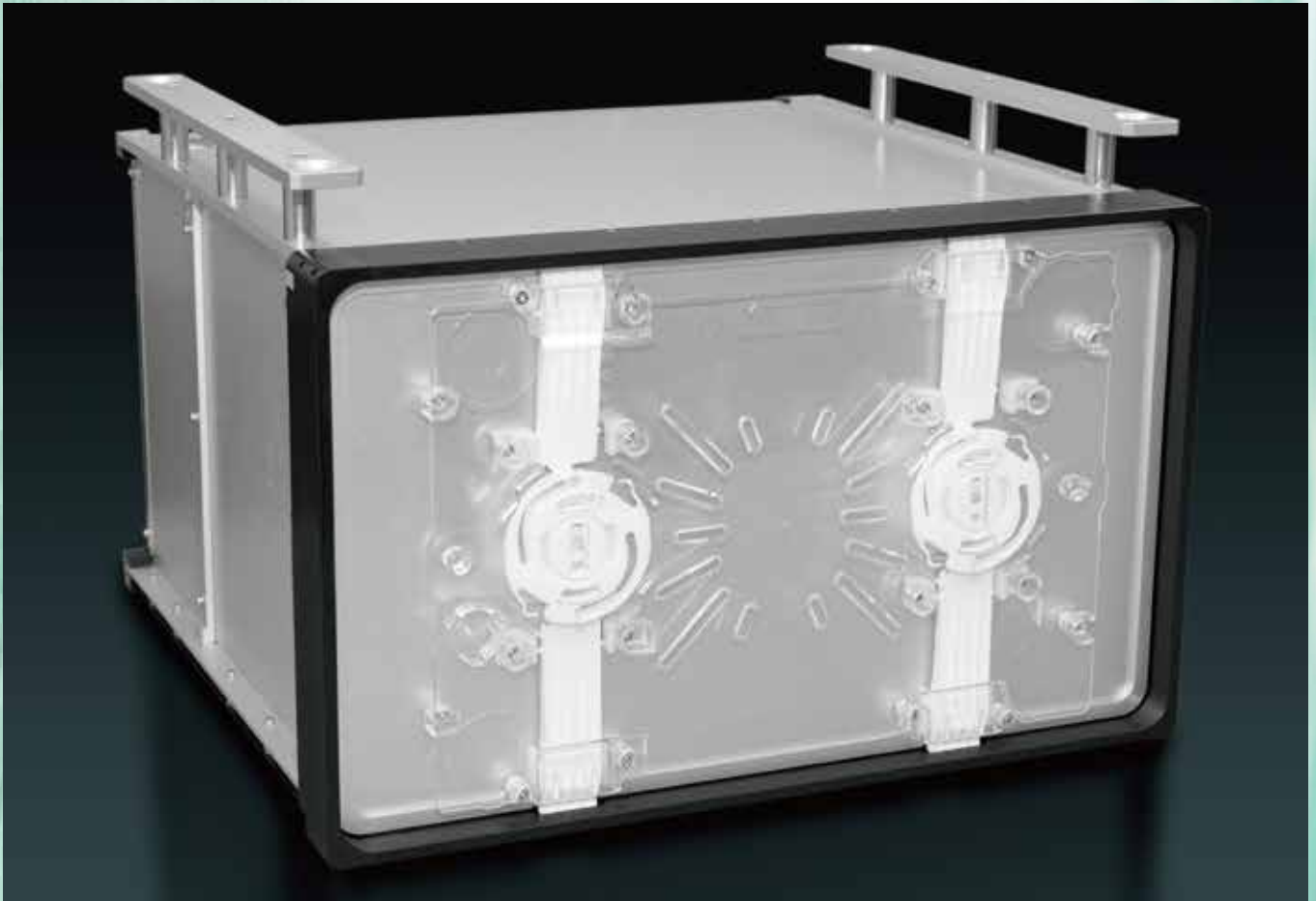
経時変化 測定結果 (PS導電タイプ*SP21)
Time-dependent Change Measurement Results (PS Conductive Type *SP21)

ShinEtsu

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第二グループ
電話番号 03-5288-8414 FAX番号 03-5288-3113

PANEL FOUP

Front Opening Unified Pod for PLP



Applications

- Front Opening Unified Pod for PLP

Features

- Conforms to SEMI Standard
- Panel size :
600mm×600mm / 510mm×515mm
- 12 or 6 Slots
- FOUP size :
740mm×703mm×437mm(H) /
619mm×599mm×437mm(H)
- Weight : 29Kg / 26Kg
- Mechanical interfaces with load port ,
Manual open / close
- Humidity control

用途

- パネルレベルパッケージ製造プロセス用

特長

- SEMI規格準拠
- パネルサイズ :
600mm×600mm / 510mm×515mm
- 12スロット / 6スロット
- サイズ :
740mm×703mm×437mm(高さ) /
619mm×599mm×437mm(高さ)
- 重量 : 29Kg / 26Kg
- ロードポートによるメカニカルインターフェイス、手動開閉可能
- 湿度コントロール

ShinEtsu

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル3階
信越ポリマー株式会社 営業第三部 第一グループ
電話番号 03-5288-8413 FAX番号 03-5288-3113